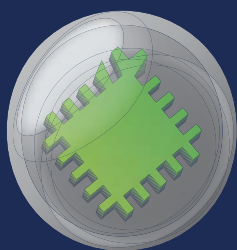


electronic design and evolution fair 2011



edefair

実施報告書

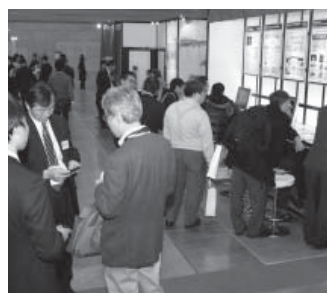
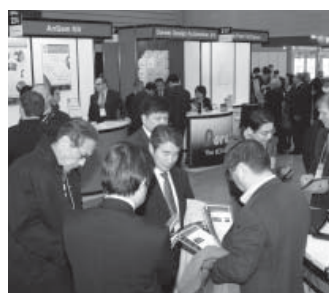
会期：2011年1月27日(木)～28日(金)

会場：パシフィコ横浜

主催：JEITA 社団法人 電子情報技術産業協会

目次

1. 開催概要	1
2. 会場構成	2
3. 出展者一覧	3
4. 出展者セミナー	3
5. スイートルーム	3
6. キーノートスピーチ	4
7. 特設ステージ	4
8. 特別ゾーン	5
9. 新興ベンダ・ガイド・ツアー	5
10. ブーススタンプラリー	5
11. プレミアムアワー	5
12. ワインのタベ	5
13. 広報活動	6
14. 来場者数・来場者分析	8



1.開催概要

(1)会期:2011年1月27日(木) 10:00-20:00 [18:00-20:00 プレミアムアワー]

1月28日(金) 10:00-18:00 [18:00-19:00 ワインの夕べ]

(2)会場:パシフィコ横浜(展示ホール、アネックスホール)

(3)主催:社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)

(4)協力:Electronic Design Automation Consortium(EDAC)

(5)後援:経済産業省、アメリカ合衆国大使館、外国系半導体商社協会(DAFS)、横浜市(順不同)

(6)協賛:社団法人電子情報通信学会(IEICE)、社団法人情報処理学会(IPSJ)、

社団法人日本電子回路工業会(JPCA)(順不同)

(7)運営:一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会(JESA)

(8)来場者数:8,016名(前年9,300名)

(9)出展者数:118社/199小間(前年113社/231小間)

(10)出展者セミナー:82セッション、延べ聴講者数2,491名(前年84セッション、延べ聴講者数2,337名)

(11)スイートルーム:3社(前年4社)

(12)ユニバーシティ・プラザ:8大学研究室(前年9大学研究室)

(13)概況

社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)は、2011年1月27日(木)~28日(金)の2日間、パシフィコ横浜にて、半導体に関連する設計、製造技術の専門性の高い情報を一堂に集めた展示会「Electronic Design and Solution Fair 2011(略称:EDSFair2011)」を開催した。

今回の開催規模は、118社・団体が199小間を出展、会期2日間で来場者8,016名となった。

11回目となる今回は、厳しい国際競争の中、日本の産業競争力を向上させ、世界をリードすべく「設計維新!」を開催テーマに、性能向上、リスクコスト削減、低消費電力化、地球環境保全などの課題を解決する新しい設計ソリューションや、世界最先端技術・サービスの展示と共に多彩なコンファレンス等を展開し、幅広く情報発信を行った。

開催初日のキーノートスピーチでは、「いよいよ始まる次世代携帯電話LTE」と題し、株式会社NTTドコモ 執行役員研究開発推進部長 尾上誠蔵氏にご登壇いただき、200名を超える来場者が熱心に聴講された。また、開催2日間を通して開催された最新の技術動向が把握できる、80セッションを超える出展者セミナーを開催。さらに、特設ステージでは、より設計者のニーズを追求した最新EDA技術を紹介する「システム・デザイン・フォーラム」の特別協力によるセッションや、ASP-DAC デザイナーズフォーラムと連携したセッション等が開催され有益な情報を展開し、各回多くの聴講者を集め最先端の技術動向を習得できる場を提供した。

さらに、エンジニアが目にする最新技術やトピックスに関する展示をまとめた特別ゾーンとして、昨年から引き続き、普段接す

ることが少ない国内外のベンチャー企業のソリューションを集めた「新興ベンダエリア」や、産学官の技術交流を深める大学の研究発表の場となる「ユニバーシティ・プラザ」、EDA開発に携わる国内のベンチャー企業が一同に集結し、日本企業ならではの「ものづくり力」を活かした技術や製品をアピールする、「JEVeCビルレッジ」合計3つの特別ゾーンを会場内に設置した。

また、今回で4年目を迎えた「新興ベンダ・ガイドツアー」では、対象企業を国内外と拡大させ、普段接する機会の少ない新興ベンダの最新技術紹介・質疑応答のサポートを行った。各回とも30名を超える方々にご参加いただき、新しい技術に出会う機会を提供した。

また、今開催では、ビジネスタイムには外出しにくい多忙な設計者などが来場しやすい環境を作るために、1月27日(木)の開場時間を2時間延長し、延長した18:00-20:00をプレミアムアワーとして開催。ブーススタンブラリーによる「iPad」が当たる来場者プレゼント抽選会や「スニッカーズ」無料配布による見学サポート、「LSI・パッケージ・ボード協調設計はどのように行われているか?」と題した、ASP-DACコラボ企画セッションが実施された。また各出展ブースでもプレミアムアワー限定イベントが数多く実施され、来場者と出展者の効率的かつ効果的なコミュニケーションとビジネスの場を提供した。次に、1月28日(金)の開催終了後に昨年に引き続き、「ワインの夕べ」を開催した。開催終了後にも関わらず、数多くの関係者にご参加いただき、出展者と来場者の交流を深める場を提供した。

3.出展者一覧 50音順

- 301 (株)アイヴィス
- 309 アットデザインリンクス(株)
Accelicon Technologies, Inc.
- 004 アトレンタ(株)
- 101 アパッチデザインソリューションズ(株)
- 303 (株)アプリスター
The DINI Group
- 204 アルテック・ジャパン(株)
- 503 アンシス・ジャパン(株)
- 403 EDN Japan
- 107 イノテック(株)
Arteris Inc.
Avalent Technologies, Inc.
Calypto Design Systems, Inc.
Duolog Technologies Ltd.
Jazz Semiconductor, Subsidiary of Tower
MoDeCH Inc.
Target Compiler Technologies N.V.
- 305 Interoperable PDK Alliance
スプリングソフト(株)
Synopsys, Inc.
- 104 (株)エーイーティー
- 102 AWR Japan
- 306 エートップテック(株)
- 304 カーボン・デザイン・システムズ・ジャパン(株)
- 206 (株)開門
- 106 兼松エレクトロニクス(株)
- 210 カリフト・デザイン・システムズ(株)
- 307 (株)クレディスト
デル(株)
UnivaUD日本事務所
- 002 CyberTec(株)
Jasper Design Automation
- 404 サイバネットシステム(株)
- 312 (株)産業タイムズ社
- 302 CMエンジニアリング(株)
- 311 JEITA ECセンター EDA標準WG
- 207 (株)スピナカー・システムズ
CAST社
Verific Design Automation社
- 405 スプリングソフト(株)
- 205 タナーリサーチジャパン(株)
- 402 TEKLA TECH A/S

- 401 日本イヴ(株)
- 203 日本オラクル(株)
- 001 日本ケイデンス・デザイン・システムズ社
イノテック(株)
アーム(株)
(株)エッチ・ディー・ラボ
カリフト・デザイン・システムズ(株)
CMエンジニアリング(株)
中部東芝エンジニアリング(株)
東芝情報システム(株)
日本システムウェア(株)
Magillem Design Services(マジレム社)
- 504 日本シノプシス合同会社
- 308 Berkeley Design Automation, Inc.
- 208 パルシックジャパンリミテッド
- 502 (株)半導体理工学研究センター(STARC)
- 310 PHYSWARE INC
- 105 フォルテ・デザイン・システムズ(株)
- 209 富士通(株)
- 103 プロトタイピング・ジャパン(株)
IRIS Technologies, Inc.
KaiSemi LTD.
- 003 MunEDA GmbH
- 501 メンター・グラフィックス・ジャパン(株)
グローバルファウンドリーズ・ジャパン(株)
エス・エム・アイ・シー・ジャパン(株)
アーム(株)
富士通セミコンダクター(株)
日本ナショナルインスツルメンツ(株)
ザイリンクス(株)

JEVeC ヒレージ

- 407 アートグラフィックス
- 409 (株)アストロン
- 406 ギガヘルツテクノロジー(株)
(株)リキッド・デザイン・システムズ
- 411 ケイレックス・テクノロジー(株)
(株)Trigence Semiconductor
- 314 (株)ジーダット
- 408 (株)ジェム・デザイン・テクノロジーズ
- 410 (株)数理システム
- 412 TOOL(株)
- 313 日本EDAベンチャー連絡会

新興ベンタエリア

- 223 ICサービス(株)
CMSC, Inc.
IST, Inc.
- 213 ICscape
- 216 AVERY DESIGN SYSTEMS
- 222 AnSem NV
- 215 (株)エイアールテック
神戸大学 工学部 永田研究室
広島大学 先端集積システム工学研究室
- 221 シグナル・プロセス・ロジック(株)
- 225 (株)シノコム
Micrologic Design Automation
ClioSoft Inc
Amiq EDA
- 218 DOCEA POWER
HD Lab
- 217 Dorado Design Automation, Inc.
- 212 (株)トプシステムズ
- 228 NANGATE, INC.
- 219 NextOp Software, Inc.
- 220 BEEcube Inc.
- 214 Blue Pearl Software
- 224 Vennsa Technologies, Inc.
- 230 POLYTEDA Software Corporation
- 211 REAL INTENT, INC.
- 229 Lynguent, Inc.

ユニバーシティ・プラザ

- 315 会津大学 齋藤研究室
- 322 愛媛大学 樋上・高橋研究室
- 317 大阪大学 今井・武内研究室
- 321 九州工業大学 梶原・温研究室
- 319 九州工業大学 中村研究室
- 318 東海大学 清水尚彦研究室
- 316 名古屋大学 組込みリアルタイムシステム研究室
- 320 広島大学 アルゴリズム論研究室

※一字下げは共同出展、順不同

4.出展者セミナー

1セッション45分間で、30~100名の適正人数のお客様に向けて集中PRが行える出展者セミナールームを提供した。
 本年はカテゴリ別に7トラックに分け、9会場にて82セッションを開催した。

聴講者数:2,491名

トラック別内訳	セッション数	27日聴講者数計	28日聴講者数計
システム設計・検証	20	87名	314名
ロジック&フィジカル設計/検証	9	70名	307名
AMS設計・検証/PCB	13	210名	106名
機能検証/テスト設計	18	223名	463名
LowPower/IP/DFM	13	177名	174名
フリー	5	63名	72名
スペシャル	4	128名	97名

5.スイートルーム

展示会場内に2タイプ(S,M)のスイートルームを設置し、出展各社が限定したお客様に落ち着いた雰囲気
 で戦略製品や未公開製品の詳細な説明が行えるとともに、重要顧客とのミーティングや商談の場として利用
 するなど、出展者のアイデア次第で実ビジネスに直結する重要な空間としてご活用いただいた。

スイートルーム設置企業

- 日本ケイデンス・デザイン・システムズ社
- 日本シノプシス合同会社
- Lynguent, Inc.

6.キーノートスピーチ

聴講者数
235名

いよいよ始まる次世代携帯電話LTE

ドコモは2010年12月にLTEのサービスを開始した。LTEは技術仕様上300Mbpsのデータ速度を実現するもので当初は最大75Mbpsが提供された。携帯電話のデータ需要急増の背景もあり、LTEは世界の多くのオペレータからの支持を得て、携帯電話の実質的な唯一の世界標準として、商用化の動きが活発化している。本講演では、携帯電話市場の状況からLTEに対するドコモの取組みや世界の動向、更に、その後の発展シナリオについて紹介した。

株式会社NTTドコモ
執行役員 研究開発推進部長
尾上 誠蔵 氏



7.特設ステージ

EDSFair2011特設ステージは、1月27日(木)に最新EDA技術を紹介する「システム・デザイン・フォーラム」の特別協力によるセッションを実施した。JEITA EDA技術専門委員会の活動から、ナノ物理設計セッション、LSIパッケージボード(LPB)セッションで構成し、設計者の知りたい情報を発信した。また、今回は、ASP-DAC(第16回アジア南太平洋設計自動化会議)の同時開催に合わせて、ASP-DAC デザイナーズフォーラムと連携し、27日にはLPB協調設計に、28日には最前線の設計に、より深く触れていただくための企画を開催した。1月28日(金)には、昨年、好評をいただいた、第一線で活躍する設計者セッションやローパワー設計セッションを今年も開催した。エンジニアはもちろん、管理職、若手技術者まで対象とした幅広い内容となった。

1/27[THU.]

13:00-13:15 オープニング・セレモニー

吉田 正昭 氏 JEITA EDA技術専門委員会 委員長
太田 光保 氏 EDS Fair 2011実行委員会 委員長
今井 浩史 氏 JEITA EDA技術専門委員会 SystemC WG主査

13:15-14:30 システムLSI設計の今後 ~22nm時代に向けて~

聴講者数
約240名

【モデレータ】
田中 正和 氏 JEITA EDA技術専門委員会 ナノ世代物理設計WG 主査
パナソニック(株) システムLSI事業本部 基盤技術開発センター 要素第一開発グループ 主任技師

【パネリスト】
小林 和淑 氏 京都工芸繊維大学 工芸科学研究科電子システム工学専攻 教授
佐藤 高史 氏 京都大学 情報学研究科通信情報システム専攻 教授
橋本 昌宣 氏 大阪大学 情報科学研究科情報システム工学専攻 准教授

14:45~ 新興ベンダ・ガイド・ツアー 第1回企業紹介

16:00-17:30 設計維新:こうすればできる。LSIパッケージボードの協調設計 ~協調設計が日本の製品を変える!~

聴講者数
約290名

【モデレータ】
小島 郁太郎 氏 日経BP社 Tech-On!編集 編集委員

【パネリスト】
岡野 資隆 氏 (株)東芝 デジタルプロダクツ&ネットワーク社
デジタルプロダクツ開発センター 実装開発センター CAD・CAE推進担当 主務
金子 俊之 氏 (株)トッパンNECサーキット ソリューションズ 設計部 マネジャー
林 靖二 氏 キヤノン(株) 生産技術本部 生産技術研究所 実装技術第三研究室 主任研究員
田中 修治 氏 ソニー(株) コンシューマー・プロフェッショナル&デバイスグループ
半導体事業本部 設計基盤技術部門 ミックスシグナルデザインソリューション部 担当部長
佐藤 厚志 氏 富士通セミコンダクター(株) 開発・製造本部 設計共通技術統括部 第一技術部
大槻 隆志 氏 (株)リコー 電子デバイスカンパニー画像LSI開発センターCAD室 シニアスペシャリスト
板橋 裕行 氏 ATEサービス(株) デザインソリューショングループ セネラルマネージャ
久島 憲司 氏 メンター・グラフィックス・ジャパン(株) テクニカルセールス本部
Advanced System Platformグループ シニアプロダクトスペシャリスト
人見 忠明 氏 アパッチデザインソリューションズ(株) シニアアプリケーションエンジニア
大坪 祐司 氏 (株)図研 技術本部 ELセクション S&Pグループ グループリーダー
永野 民雄 氏 ルネサスエレクトロニクス(株) 技術開発本部 プラットフォームインテグレーション
統括部 アナログ設計技術開発部 主任技師

18:00-18:45 ASP-DACコラボ企画 LSIパッケージボード協調設計は行われているか? ~協調設計の事例紹介と普及への課題~

聴講者数
約170名

■ショートスピーチ
「パワーインテグリティと協調設計」
須藤 俊夫 氏 芝浦工業大学 機能電子回路研究室 教授

■座談会
【パネリスト】
・ASP-DAC側代表
永田 真氏 神戸大学大学院 システム情報学研究科 教授
ASP-DAC2011デザイナーズフォーラム副委員長
松波 敬祐 氏 ソニー(株) 生産本部 設計技術センター 設計技術戦略課
統括課長 DE(Distinguished Engineer)
福場 義憲 氏 (株)東芝 セミコンダクター社 アナログ・イメー징IC事業部
設計技術開発部 設計インフラ担当 参事/
JEITA EDA技術専門委員会 LPB相互設計WG 主査

・JEITA・LPB相互設計WG代表
岡野 資隆 氏 (株)東芝 デジタルプロダクツ&ネットワーク社
デジタルプロダクツ開発センター 実装開発センター CAD・CAE推進担当 主務
田中 修治 氏 ソニー(株) コンシューマー・プロフェッショナル&デバイスグループ
半導体事業本部 設計基盤技術部門 ミックスシグナルデザインソリューション部 担当部長
大坪 祐司 氏 (株)図研 技術本部 ELセクション S&Pグループ グループリーダー

1/28[FRI.]

10:30-12:00 設計者が語る成功へのヒント、失敗の教訓

聴講者数
約190名

【司会】
松澤 昭氏 東京工業大学 大学院理工学研究科 電子物理工学専攻 教授
【プレゼンター】
丸子 健一 氏 ソニー(株) 半導体事業本部 研究開発部門 アナログ回路開発2部1課
中島 雄二 氏 ルネサスエレクトロニクス(株) 技術開発本部 ミックスシグナルコア開発統括部
アナログコア開発第一部
吉岡 正人 氏 (株)富士通研究所 デザインソリューション研究部
力野 邦人 氏 エフソフトコム(株) QIプロジェクト 主事

13:30~ 新興ベンダ・ガイド・ツアー 第2回企業紹介

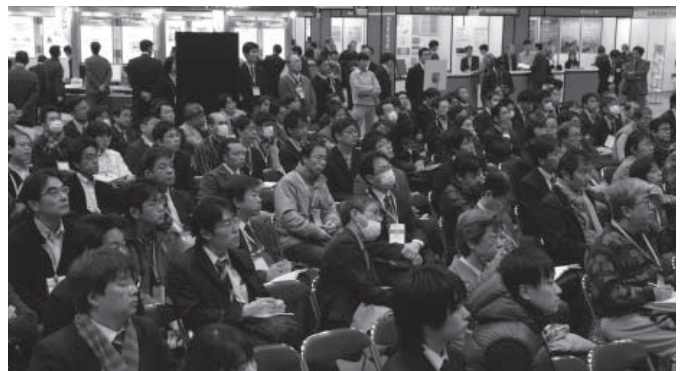
14:45~ 新興ベンダ・ガイド・ツアー 第3回企業紹介

16:00-17:30 ユーザから見た携帯電話の省エネ技術 ~スマートフォンへ向けた取り組み~

聴講者数
約170名

【モデレータ】
富山 宏之 氏 立命館大学 理工学部 教授

【パネリスト】
入田 隆宏 氏 ルネサス モバイル(株) モバイルマルチメディア事業本部 SoC事業部
モバイルSoC設計第一部 担当部長
神山 剛氏 (株)NTTドコモ 先進技術研究所
山下 浩一郎 氏 (株)富士通研究所 プラットフォームテクノロジー研究所 主任研究員



8.特別ゾーン

EDSFair2011では、エンジニアが注目する最新技術やトピックスに関する、特別ゾーンを設置した。

■新興ベンダエリア 出展者数 26社

普段接することが少ない国内外のベンチャー企業のソリューションを集めた「新興ベンダエリア」を設置し、設計開発者に向けて世界の最新情報をいち早くお届けした。

■JEVeCビレッジ 出展者数 11社

日本のEDAの発展を目指して設立された「日本EDAベンチャー連絡会(JEVeC)」との協力による特別企画として実施。EDA開発に携わる国内のベンチャー企業が一堂に集結し、日本企業ならではの「ものづくり力」を活かした技術や製品をアピールした。

■ユニバーシティ・プラザ 参加大学 8研究室

産学の交流を促進するとともに、日本におけるEDA技術、システムLSI設計技術を始めとした電子回路設計技術およびソリューション技術の更なる向上を図ることを目的として、国内外の大学機関による研究の成果を発表するプラザを展開。

9.新興ベンダ・ガイド・ツアー

日ごろからお忙しい「設計・設計環境構築エンジニア」の皆様へのガイドツアー

日本の設計技術・EDA技術の第一人者がツアーガイドとして、特設ステージで国内外新興企業の主要な技術を日本語でご紹介後、ブースへ同行訪問し、各社の技術紹介・質疑応答をサポートした。

■ツアースケジュール

1/27[THU.]	1/28[FRI.]	
第1回: 14:45-15:55	第2回: 13:00-14:10	第3回: 14:45-15:55
(株)シンコム POLYTEDA Software Corporation ICサービス(株) Dorado Design Automation, Inc. Interoperable PDK Alliance TEKLATECH A/S	Lynguent, Inc. (株)エイアールテック (株)トプシステムズ シグナル・プロセス・ロジック(株) アートグラフィックス (株)ジェム・デザイン・テクノロジー	AVERY DESIGN SYSTEMS Vennsa Technologies, Inc. NextOp Software, Inc. DOCEA POWER REAL INTENT, INC. CMエンジニアリング(株)

■ツアーガイド

1/27[THU.]

(株)半導体理工学研究センター
開発第1部 部長代理
村方 正美 氏



1/28[FRI.]

独立行政法人科学技術振興機構
イノベーション推進本部産学基礎基盤推進部
事業計画・調整担当 主任調査員
秋山 俊恭 氏



10.ブーススタンプラリー

登録所または会場入口で配布される、スタンプラリーシートに、訪問した出展者ブースのスタンプ5社分を集め抽選に参加。また27日の19:00-20:00は特賞が当たる抽選が行われた。

賞品:ギフト券(1,000円相当)× **700** 名様
特賞:iPad × **10** 名様

11.プレミアムアワー 1/27[THU.] 18:00-20:00

■来場者プレゼント抽選会[特賞]

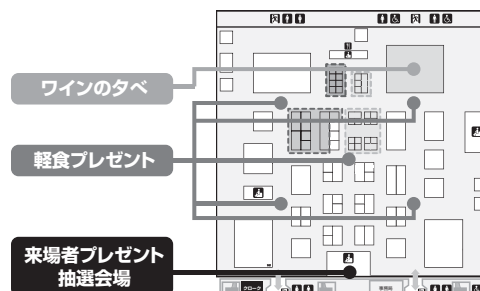
19:00-20:00の1時間限定でブーススタンプラリーの景品がグレードアップ。「特賞:iPad(10名様)」を抽選でプレゼントされた。

■軽食プレゼント

展示会場内、プレミアムアワー中、「スニッカーズ」が無料配付された。

■出展ブースイベント

展示会場内にて、プレミアムアワー中、出展者による来場者向けの様々なイベント企画が実施された。



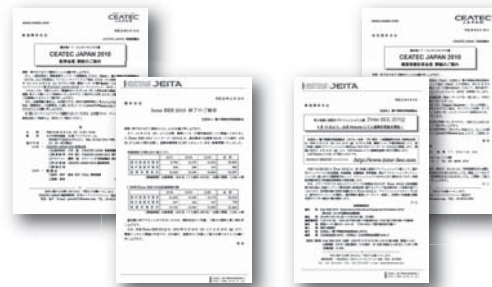
12.ワインのタベ 1/28[FRI.] 18:00-19:00

昨年に引き続き、EDSFair2011閉館後に、展示会場内特設ステージにおいて、来場者と出展者との交流の場として「ワインのタベ」を開催した。多くの方々にご参加いただき、1年に1度、関係者との交流をはかる場として活用された。

13. 広報活動

(1) 報道発表

- ① 出展募集リリース配信(6月9日)
- ② 入場事前登録開始リリース(12月1日)
- ③ 開催告知／取材誘致リリース配信(1月20日)
- ④ 終了報告リリース配信(1月28日)



(2) 会場でのプレス対応

プレスルームの設置および運営(1月27日-28日)



(3) メール配信

過去来場者データベースおよび、今年の事前登録者に向けて「EDSFair2011 OFFICIAL MAIL NEWS」として12回配信。

(4) PRツール(印刷物)の作成

- ① 出展のご案内(和・英)
- ② 新興ベンダエリア出展のご案内(英)
- ③ 案内状(事前DM)／封筒(和)
- ④ 会場案内図(和)



(5) 公式Website

- ① URL
www.edsfair.com

- ② 概要

出展者のための情報と、来場者のための情報を網羅した、EDSFair公式Website。多くの皆様にご覧いただいた。また、出展情報や最新リリースを出展者自身によりリアルタイムにUPできる機能や、業界最新ニュースの掲載など、出展者・来場者にとってより利便性が高く、最新情報を発信するWebsite構築を目指した。

- ③ 基本統計データ

(2010年12月1日～2011年2月28日)

合計来場者数	127,823
総ページ閲覧数	698,050

- ④ 出展者情報更新回数

685回(2010年10月21日～2011年1月28日)



14. 来場者数・来場者分析

■ 来場者数

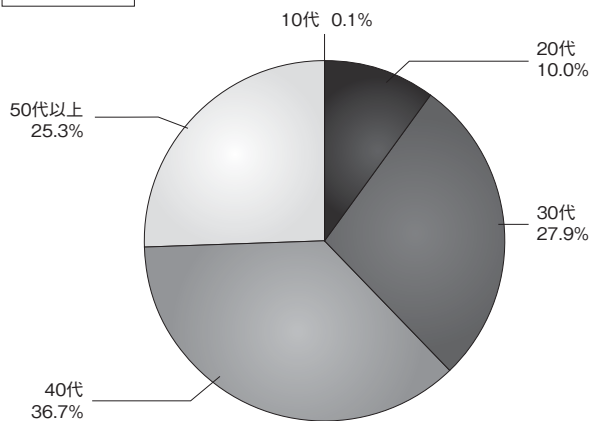
日付	天候	来場者数
1月27日(木)	晴 れ	3,856名
1月28日(金)	晴 れ	4,160名
合 計		8,016名

■ 来場者数の推移

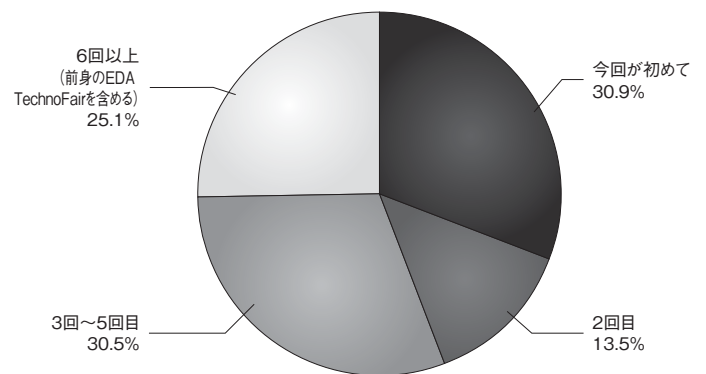
2010年	9,117名
2009年	9,300名
2008年	10,431名

■ 来場者の属性

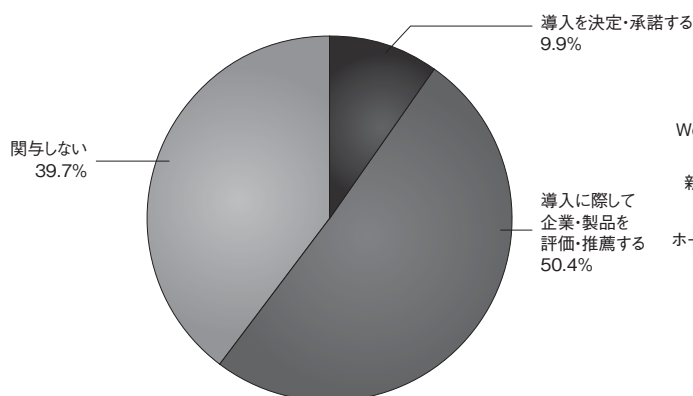
年 代



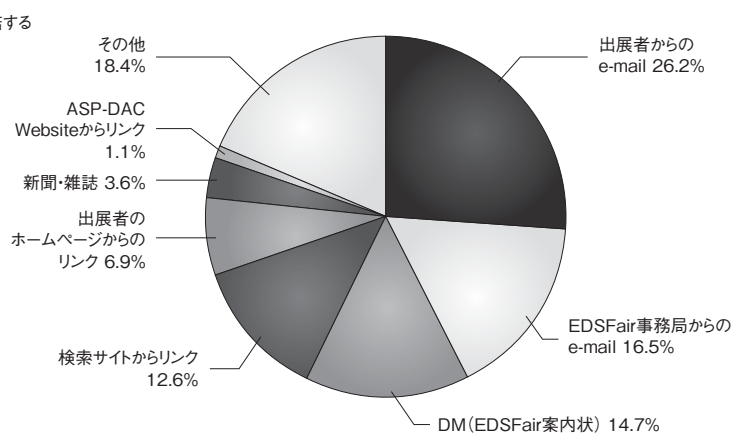
来場頻度



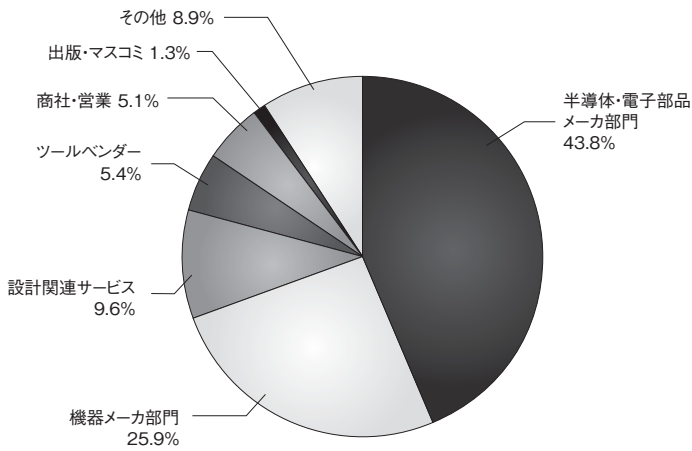
製品導入権限



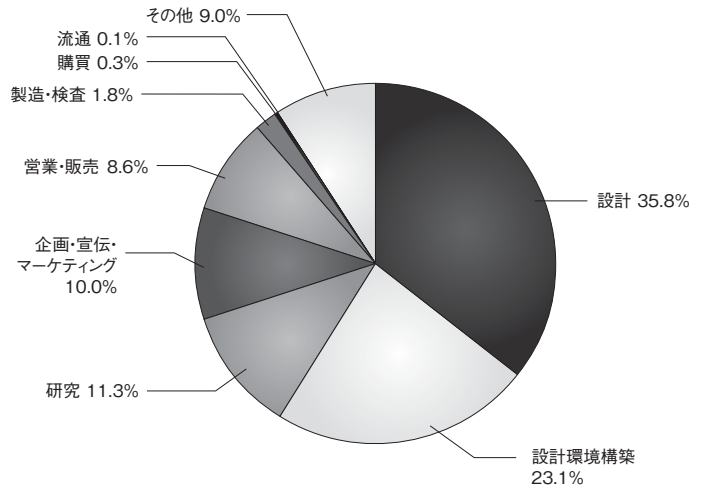
EDSFairの認知経路



業 種

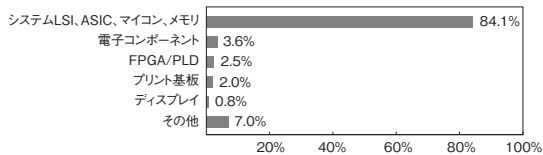


職 務

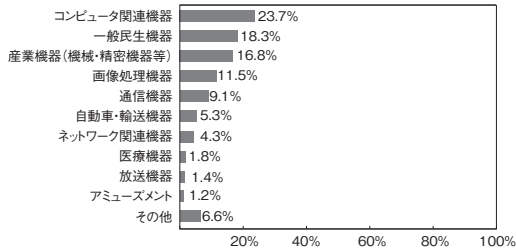


・業種詳細

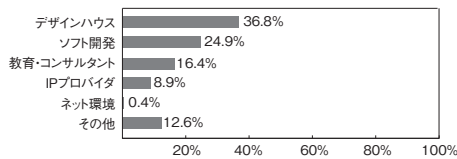
○半導体、電子部品メーカ・部門 43.8%



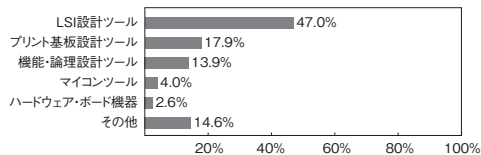
○機器メーカ・部門 25.9%



○設計関連サービス 9.6%

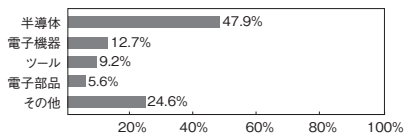


○ツールベンダ 5.4%



○商社・商業 5.1%

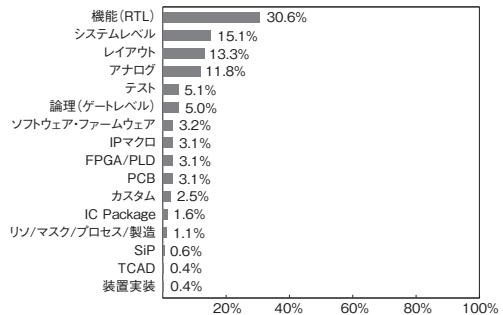
※ツール関連が主要営業品目である商社・代理店は除く



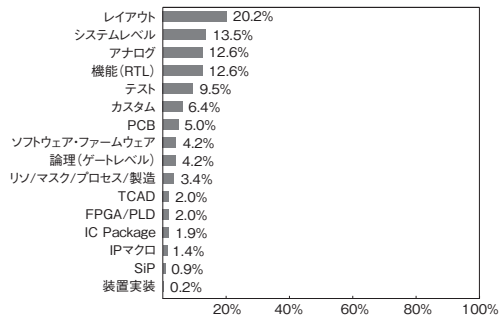
○出版・マスコミ 1.3%

・職務詳細

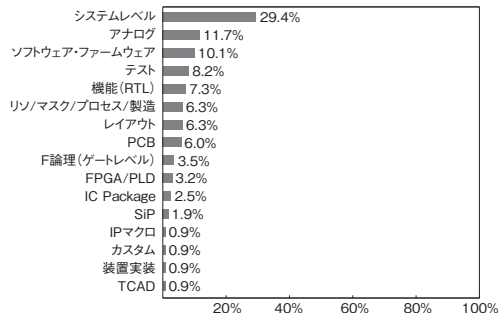
○設計 35.8%



○設計環境構築 23.1%



○研究 11.3%



○企画・宣伝・マーケティング 10.0%

○営業・販売 8.6%

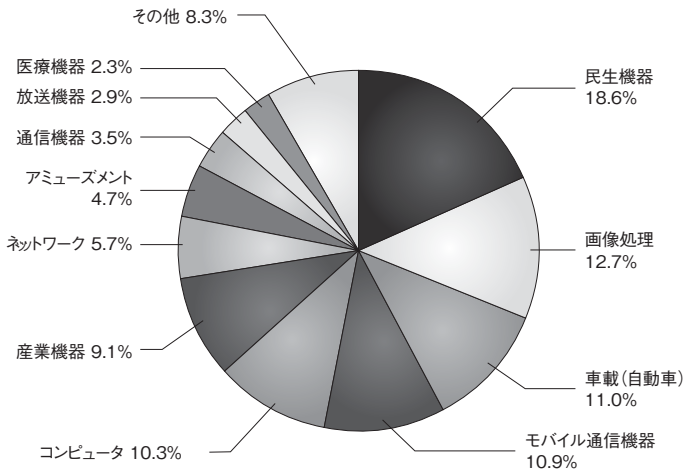
○製造・検査 1.8%

○購買 0.3%

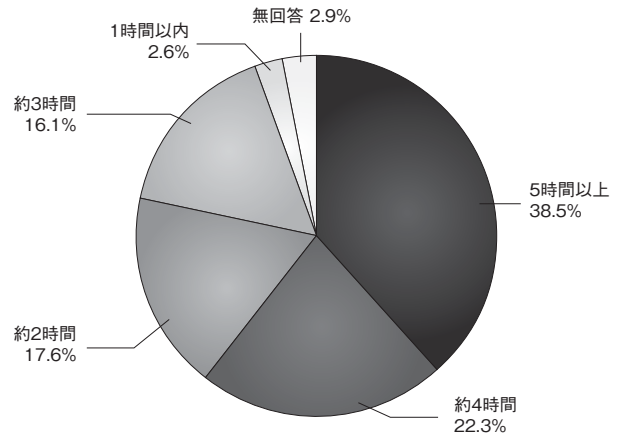
○流通 0.1%

■ 来場者アンケート (会期終了後インターネットによるアンケートを実施)

担当アプリケーション

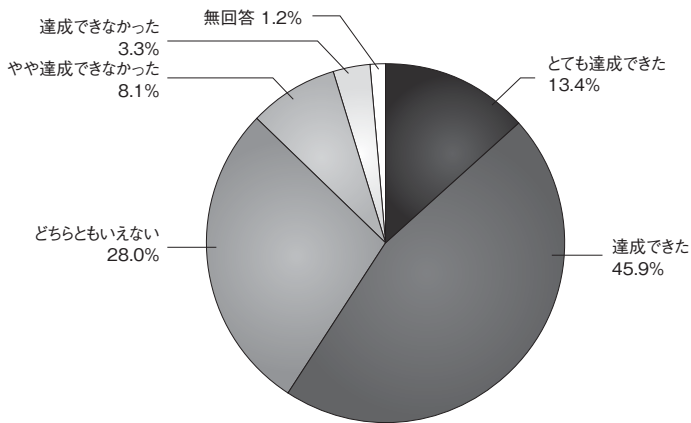


会場滞在時間

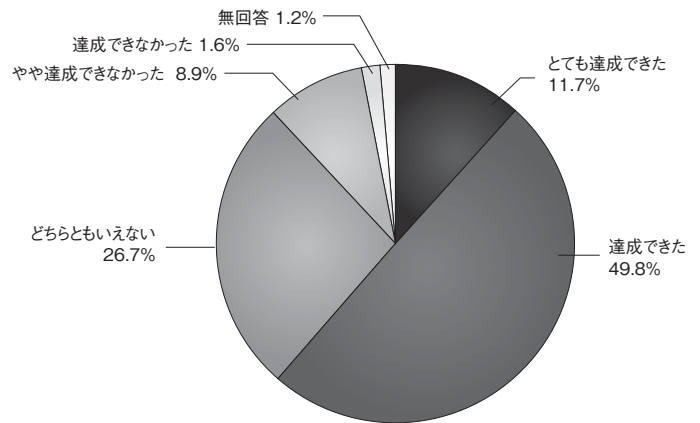


来場目的の満足度

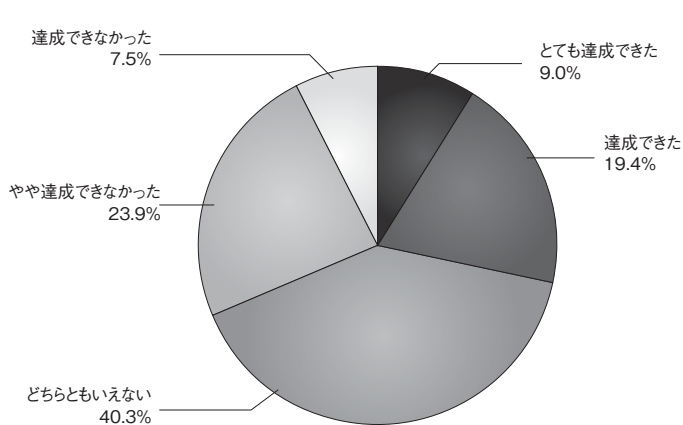
・製品の最新情報入手



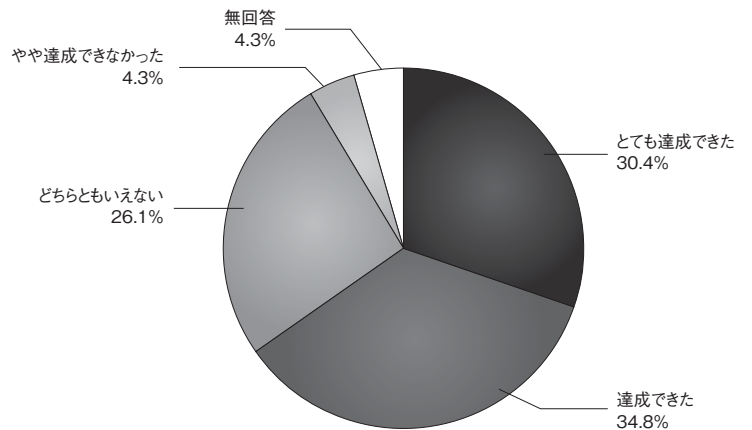
・設計技術や設計事例の最新情報入手



・競合他社の情報入手



・商談



主催

社団法人 電子情報技術産業協会

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル 5F
<http://www.jeita.or.jp>

運営・お問い合わせ

一般社団法人 日本エレクトロニクスショー協会

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル 12F
電話03-6212-5231(代表) FAX(03)6212-5225
E-mail : info2011@edsfair.com